國立交通大學

機械工程研究所

碩士論文

化學機械研磨製程之控片與樣片之移除率及不平坦 度預測與分析 Predict and analyze removal rate and non-planarization index of blanket wafer and pattern wafer in chemical mechanical polishing process

研究生:袁啟文

- 指導教授:陳宗麟 博士
 - 林家瑞 博士

中華民國九十七年六月

化學機械研磨製程之控片與樣片之移除率及不平坦度預測與分析 Predict and analyze removal rate and non-planarization index of blanket wafer and pattern wafer in chemical mechanical polishing

process

研究生:袁啟文 指導教授:陳宗麟 博士 林家瑞 博士 Student : Chi-Wen Yuan Advisor : Dr. Tsung-Lin Cheng Dr. Chia-Shui Lin



Submitted to Institute of Mechanical Engineering College of Engineering National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Mechanical Engineering

June 2008 Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年六月

化學機械研磨製程之控片與樣片之移除率及不平坦度 預測與分析

學生:袁啟文

指導教授:陳宗麟 博士

林家瑞 博士

國立交通大學機械工程學系



化學機械研磨(Chemical-Mechanical Polish, CMP)是一個極為複雜 的製程,其中包括物理、化學及機械的研究領域[1];而其研磨的過程, 主要是靠機械手臂上的晶圓載具吸起晶圓置於研磨墊上,同時旋轉晶 圓載具的吸盤及研磨墊來研磨晶圓。在研磨的過程中,研磨墊會因為 研磨晶圓而不斷的耗損;當研磨墊耗損到一定程度的時候,就必須手 動使用刷子刷研磨墊,恢復研磨墊的摩擦率;或更換新的研磨墊,使 晶圓的移除率維持在一定的標準內。

目前的晶圓廠測試研磨墊的磨擦率的方法,大致為:在研磨過數

千至數萬片的樣片(pattern wafer)之後,研磨一片控片(blanket wafer), 並觀察控片的移除率,來確定研磨墊的摩擦率是否過低。

本實驗是以控片的移除率(Material Remove Rate)及不平坦度 (Non-Planarization Index)的模型(Model)為基礎模型,再以最小平方法 (The Least Square Method),來求出 NDL 常用的樣片的移除率及不平坦 度的模型,使可以在用同樣的條件進行研磨的時候,以控片的移除率 及不平坦度,推得樣片的移除率及不平坦度;或反之,以樣片的移除 率及不平坦度,推得控片的移除率及不平坦度,進而達到節省控片使 用之目的。

Predict and analyze removal rate and non-planarization index of blanket wafer and pattern wafer in chemical mechanical polishing process

Student : Chi-Wen Yang

Advisor: Dr. Chia-Shui Lin

Dr. Tsung-Lin Chen



Chemical-Mechanical Polish is an extremely complicated process because it involves physical, chemical, and mechanical field [1]. And the process of polishing is using carrier on the mechanical arm to get wafers. Then Carrier put the wafer on the pad, and polish wafer with turning itself and pad. With this process, pad could be fewer, because of polishing wafers. When the frictional forces of the pad is too low, we have conditioning the pad or changing another new pad.

Nowadays, when many factories want to check the pad, always after polishing thousands of pattern wafers then polish one blanket wafer. And check blanket wafer to make shore that the frictional forces of the pad is ok or not.

This experiment is used the model of the material remove rate and the non-planarization index of the blanket wafer to predict the model of the material remove rate and the non-planarization index of the pattern wafer. Then we can use the material remove rate and the non-planarization index of the pattern wafer to predict the material remove rate and the non-planarization index of the blanket wafer, and check the frictional forces of the pad is ok or not. And then we can reduce the wasting of the blanket wafer.

致謝

在交大讀了兩年書,最主要感謝的就是身為指導教授的 林家瑞 老師以及在老師過世之後接著指導我的 陳宗麟老師;另外也感謝NDL 內的工程師細心的指導。研究生的生活雖然比從前在當大學生時為 累,但也過的比從前充實。最後感謝口試委員 鄭泗東老師以及 黃振 榮博士的指教,使我的論文得以更加充實。



摘要	
目錄	
符號訪	之明
第一章	を序論1
1.	1 研究動機與目的1
1.	2 文獻回顧
1.	3 研究方法
1.	4 本文組織架構
第二章	* 機台介紹
2.	1 化學機械研磨基本架構
2.	2 熱場發射掃描是電子顯微鏡介紹8
2.	3 n&k-薄膜測厚儀介紹10
2.	4 化學機械研磨基本參數11
2.	5 研磨漿料的配置13
第三章	查實驗設計法與模型建立14
3.	1 實驗設計法14
3.	2 最小平方法原理17
3.	3 建立化學機械研磨系統模型17

第四章	實驗概況19
4.1	實驗設備19
4.2	實驗材料
4.3	實驗規劃及步驟
第五章	系統模擬與實驗數據比較23
5.1	研磨漿料的配置
5.2	移除率下降率的模型建立 24
5.3	SiO ₂ 控片的移除率模型建立25
5.4	樣片的移除率模型建立
5.5	模型之適配度之計算
5.6	不平坦度之研究
5.7	模型間關係概況
第六章	結論及未來工作
參考文廳	默

表目錄

表 3.	1 實驗設計步驟大綱 35
表 5.	1研磨液不同比例之移除厚度(Å)35
表 5.	2連續研磨之移除厚度(Å)35
表 5.	3 SiO ₂ 之控片實驗固定參數值
表 5.	4 模型DF=4 psi,SP=20 rpm,FR=150m1/min36
表 5.	5 模型DF=2 psi,SP=20 rpm,FR=150m1/min36
表 5.	6 模型DF=6 psi,SP=20 rpm,FR=150m1/min36
表 5.	7 模型DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min36
表 5.	8 模型DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min37
表 5.	9 模型DF=6 psi,SP=40 rpm,FR=150m1/min37
表 5.	10 模型DF=2 psi,SP=20 rpm,FR=250m1/min37
表 5.	11 模型DF=4 psi,SP=20 rpm,FR=250m1/min37
表 5.	12 模型DF=6 psi,SP=20 rpm,FR=250m1/min38
表 5.	13 模型DF=2 psi,SP=40 rpm,FR=250m1/min38
表 5.	14 模型DF=4 psi,SP=40 rpm,FR=250m1/min38
表 5.	15 模型DF=6 psi,SP=40 rpm,FR=250m1/min38
表 5.	16 模型DF=6 psi,SP=20 rpm,FR=200m1/min39
表 5.	17 模型DF=6 psi,SP=30 rpm,FR=200m1/min39

表 5.	18	模型DF=2	psi,	SP=30	rpm,	FR=150m1	l/min	••••	••••	39
表 5.	19	模型DF=4	psi,	SP=30	rpm,	FR=150m	l/min	••••	••••	39
表 5.	20	模型DF=6	psi,	SP=30	rpm,	FR=150m	l/min	••••	••••	40
表 5.	21	模型DF=2	psi,	SP=20	rpm,	FR=200m	l/min	••••	••••	40
表 5.	22	模型DF=4	psi,	SP=20	rpm,	FR=200m2	l/min	••••	••••	40
表 5.	23	模型DF=2	psi,	SP=30	rpm,	FR=200m2	l/min	••••	••••	40
表 5.	24	模型DF=4	psi,	SP=30	rpm,	FR=200m2	l/min	••••	••••	41
表 5.	25	模型DF=2	psi,	SP=40	rpm,	FR=200m	l/min	••••	••••	41
表 5.	26	模型DF=4	psi ,	SP=40	rpm ,	FR=200m	l/min	••••	••••	41
表 5.	27	模型DF=6	psi ,	SP=40	rpm ,	FR=200m	l/min		••••	41
表 5.	28	模型DF=2	psi,	SP=30	rpm-i	FR=250m	l/min		••••	42
表 5.	29	模型DF=4	psi,	SP=30	rpm,	FR=250m	l/min	••••	••••	42
表 5.	30	模型DF=6	psi,	SP=30	rpm,	FR=250m	l/min	••••	••••	42
表 5.	31	樣片實驗[固定参	數值.	••••		••••	••••	••••	43
表 5.	32	模型DF=2	psi,	SP=20	rpm,	FR=150m	l/min		••••	43
表 5.	33	模型DF=4	psi,	SP=20	rpm,	FR=150m	l/min	••••	••••	43
表 5.	34	模型DF=6	psi,	SP=20	rpm,	FR=150m	l/min		••••	43
表 5.	35	模型DF=2	psi,	SP=40	rpm,	FR=150m	l/min	••••	••••	44
表 5.	36	模型DF=4	psi,	SP=40	rpm,	FR=150m	l/min			44

表 5.	37	模型DF=6	psi,S	SP=40	rpm ,	FR=150m1	/min	••••	 . 44
表 5.	38	模型DF=2	psi,S	SP=20	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 44
表 5.	39	模型DF=4	psi,S	SP=20	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 45
表 5.	40	模型DF=6	psi,S	SP=20	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 45
表 5.	41	模型DF=2	psi,S	SP=30	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 45
表 5.	42	模型DF=4	psi,S	SP=30	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 45
表 5.	43	模型DF=6	psi,S	SP=30	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 46
表 5.	44	模型DF=2	psi , S	SP=40	rpm,	FR=200m1	l/min	••••	 . 46
表 5.	45	模型DF=4	psi ,	SP=40	rpm ,	FR=200m1	l/min	••••	 . 46
表 5.	46	模型DF=6	psi , S	SP=40	rpm ,	FR=200ml	l/min	• • • • •	 . 46
表 5.	47	模型DF=2	psi,S	SP=20	rpm-,	FR=250m1	l/min	• • • • •	 . 47
表 5.	48	模型DF=4	psi,	SP=20	rpm,	FR=250m1	l/min	• • • • •	 . 47
表 5.	49	模型DF=6	psi,S	SP=20	rpm,	FR=250m1	l/min	••••	 . 47
表 5.	50	模型DF=2	psi,S	SP=30	rpm,	FR=250m1	l/min	• • • • •	 . 47
表 5.	51	模型DF=4	psi,S	SP=30	rpm,	FR=250m1	l/min	••••	 . 48
表 5.	52	模型DF=6	psi,S	SP=30	rpm,	FR=250m1	l/min	• • • • •	 . 48
表 5.	53	模型DF=2	psi,S	SP=40	rpm,	FR=250m1	l/min	••••	 . 48
表 5.	54	模型DF=4	psi,S	SP=40	rpm,	FR=250m1	l/min	••••	 . 48
表 5.	55	模型DF=6	psi,S	SP=40	rpm,	FR=250m]	l/min	••••	 . 49

表 5.	56	模型DF=2	psi	, SP=30	rpm ,	FR=150m1/min	 49
表 5.	57	模型DF=4	psi	, SP=30	rpm,	FR=150m1/min	 49
表 5.	58	模型DF=6	psi	, SP=30	rpm,	FR=150m1/min	 49



圖目錄

圖 1.	1 晶圓製程流程	50
圖 1.	2 有無化學機械研磨之晶圓切面圖	50
圖 1.	3 實驗流程圖	51
圖 2.	1 化學機械研磨機台外觀圖[8]	51
圖 2.	2 化學機械研磨架構簡圖[7]	52
圖 2.	3 熱場發射掃描式電子顯微鏡-TFSEM結構圖[8]	53
圖 2.	4 影像觀測顯示圖[8]	54
圖 2.	5 熱場發射掃描式電子顯微鏡掃出之圖	54
圖 2.	6 n&k-薄膜測厚儀結構圖[8]	55
圖 2.	7 NK1500-薄膜厚度分析儀外觀[8]	55
圖 2.	8 配置研磨將廖流程圖	56
圖 3.	1製程或系統模圖	56
圖 3.	2 MATLAB 7.0 程式介面圖	57

圖 4. 1 n&k薄膜測厚儀量測之 9 點之簡圖57

圖 5.	1	<i>Al₂O₃</i> 對Cu及SiO ₂ 之移除率比較圖58
圖 5.	2	硝酸對Cu及SiO ₂ 之移除率比較圖58
圖 5.	3	SiO ₂ 控片之移除率下降模型圖59
圖 5.	4	樣片之移除率下降模型圖 59
圖 5.	5	總誤差 $Y_t - \overline{Y}$ 之分割圖
圖 5.	6	SiO ₂ 之控片不平坦度 60
圖 5.	7	樣片不平坦度



第一章 序論

1.1 研究動機與目的

由於IC產品的尺寸日漸縮小以及層次越來越多,而黃光製程對景 深(Depth of Focus)有一定的限制,故對平坦化有一定的要求,再加 上晶圓的製成過程頗為繁雜,如圖1.1;特別是多層的晶圓,更是對 平坦化技術有著重大的需求,而有化學機械研磨與否,則有著非常明 顯的差異存在,如圖1.2。

化學機械研磨技術可提高元件產品的良率,而且在其不斷的改良 之下,已可將整個拋光區域之間的乎坦度差異日趨縮小;而在產品可 靠性方面也有相當的有成就,雖然此技術為全面平坦化製程的一個重 要過程,不過從以前到現在,仍然無法得知確切的磨耗機制仍是相當 令人困擾的一個課題。

由於拋光的過程除了靠機械力之外,拋光液在晶圓表面亦產生化 學作用。因為結合化學反應與機械拋光製程對現在而言,尚未完全掌 握的關係;若只有單純的等向性化學作用是無法達到全面性平坦度, 如果只考慮到機械拋光作用將會降低加工速率且容易刮傷晶圓表 面,因此非常需要探討這種結合化學與機械作用之動態交互反應,了 解晶圓表面材料是如何被移除。

此外,化學機械研磨是半導體製程中相當重要的一道製程;。因 為機制簡單,但由於大多為耗材性元件,所以製程中會有相當大的變 異,而用來拋光晶圓表面的研磨墊就是其中之一。然而,目前大晶圓 廠的化學機械研磨的製程部門,仍舊只是運用控片來決定是否應該更 換研磨墊。但是,若能直接找出樣片與控片之間的移除率的關係,就 可以在固定的製程參數下的控片移除率,推算出在同樣條件下樣片的 移除率,也能夠大量減少研磨控片所浪費的時間,以及晶圓。



1.2 文獻回顧

化學機械研磨(Chemical Mechanical Polishing, CMP)在半導體製 程技術中已經被大家公認為最有效之全面性平坦化(Global Planarization)的技術。關於 CMP 製程,最早起源於 IBM,大約在 1980 年代初期,最早 IBM 是為了解決製造 IC 時,因為晶圓的表面線路圖 案會引起鏡膜後表面的高低起伏,進而導致微影製程聚焦不良的問 題,因此 IBM 開發了此項平坦化技術。 不久後,IBM 提出了金屬鑲嵌(Damascene)的概念,促使 CMP 技術實際化[2]。此一金屬鑲嵌(Damascene)之概念亦即將介電層予以圖 案化後再填入金屬層,然後再將最上層之金屬層予以回蝕刻(Etch Back),使金屬面與介電層在同一平面上,如此反覆幾次製程即可以 產生多重連線元件。

而現在,積體電路線寬不斷的縮小以及線密度不斷的提高,如此 之發展趨勢使得平坦化的要求不斷提高,使得 CMP 成為平坦化技術 之主流。

就一般而言,移除率是根據Preston的方程式[3]:

$$RR = \frac{\Delta h}{\Delta t} = K_p PV$$

其中 RR 為移除率, K_p 為移除係數, $P = \frac{F}{A}$,且 F 為研磨墊上的正
向力, A為晶圓及研磨墊的接觸面積,V則為研磨墊及載具的相對轉
速。

在樣片與控片的比較中,由於樣片有一些較高的點,會使在同壓 力時的晶圓與研磨墊接觸面較小,然而在不平坦的部份研磨完後,其 移除率則會與控片差不多[4]。

進而使得樣片的移除率和控片的移除率之間,只存在著一個時間 函數的差距[5]:

 $RR_{patterned} = T_f \times RR_{blanket}$

其中T_f為研磨時間的方程式。

而本實驗最主要的目的就是借由RR_{patterned}的模型,以及RR_{blanket}的模型,來找出T_f所代表的方程式的模型。

1.3 研究方法

本研究的對象為樣片及控片的移除率和不平坦度之間的關係。先 沉積出二氧化矽的薄膜,然後其中一部分的晶圓已黃光微影出圖形 (此中的圖形使用NDL中較常使用的光冊),再以蝕刻機台在二氧化矽 上蝕刻出圖形,並繼續度上銅膜,之後再以CMP機台,將薄膜的部份, 研磨至同時可見到銅以及二氧化矽。

之後其中之控片以n&k-薄膜測厚儀量測二氧化矽的厚度;而樣片 在研磨前先取一片破片,將其以熱場發射掃描式電子顯微鏡(TFSEM) 量測二氧化矽+銅的厚度。再以CMP各自研磨晶圓,其後控 片以同前之法量測而樣片則全部破片以前述之方式量測。 過程如圖1.3。

而在研磨樣片之前,由於原本研磨銅以及二氧化矽所

使用的研磨漿料是不同的,其中無法使用研磨二氧化矽的研磨漿料 來研磨銅,而研磨銅的研磨漿料是由三氧化二鋁以及硝酸以一定比例 配置而成,而且目前不確定是否有可以同時研磨銅與二氧化矽的研磨 漿料,必須從新配置。在此決定以銅的研磨漿料三氧化二鋁和硝酸在 不同比例下配置出使銅以及二氧化矽的研磨率非常接近的研磨漿料 來研磨樣片。

在得知控片及樣片的移除率之後,就可以最小平方法 建立控片及樣片的模型,也可求出控片及各式樣片的不平 坦度,最後即可瞭解控片及樣片的移除率及不平坦度之間 的關係。

1896

1.4 本文組織架構

首先在第二章提出有關於化學機械研磨機台的基本架構,以及用 來量測樣片的量測機台熱場發射掃描式電子顯微鏡,和用來量測控片 的量測機台n&k-薄膜測厚儀的基本架構,晶圓與化學機械研磨之間的 關係參數,以及機台的哪些製程參數是主要參數。第三章先提出最小 平方法的基本原理,再以其作出預測模型來找出樣片與控片之間的關 係。第四章以實驗來收集樣片及控片的移除率及不平坦度數據,和預 測模型相互印證。第五章則是對此研究作出結論,並且於第六章提出 未來之工作展望。



第二章 機台介紹

2.1 化學機械研磨基本架構介紹

化學機械研磨(Chemical-Mechanical Polish)簡稱 CMP, 整體 機台如圖 2.1,其中是使用含有微細研磨拋光粉粒之拋光研磨液,配 合研磨墊的機械運動來進行化學蝕刻與機械拋光,以達到研磨目的 [6]。其簡圖如圖 2.2[7]:

整個流程大致上是藉著研磨漿料與晶圓材質起化學反應,同時研 磨粒也會藉著機械力磨蝕晶圓表面,而碎屑則由研磨漿料帶走。 CMP 的基本結構,如圖 2.2[7]所示,其主要部分包含[1]:

(1) 晶圓載具(Carrier):

主要是用真空吸附的裝置吸住並固定晶圓,並且當晶片接觸到研 磨墊時會在晶片背部施以一背壓(Back Pressure),目的是使晶圓受力 均勻,以進行研磨。

mann

(2) 研磨平台(Platen):

此研磨平台上黏附一研磨墊,其功能在於利用旋轉使研磨墊(pad) 和欲研磨之晶片做一相對運動,以進行研磨的動作。

(3) 研磨墊(pad):

研磨墊材料的不同以及表面構造形狀的相異,會使得研磨有著不同的效果。然而研磨墊是一消耗品,隨著研磨時間的增加,研磨墊長時間受到壓力的壓擠以及與晶片之間之磨耗都會使得研磨墊產生鈍 化現象,這時研磨墊的修整(Conditioning)就很重要。而本研究所探討 的就是如何在不作修整(Conditioning)研磨墊條件下,來控制輸入之研 磨時間,以達到相同的目標移除厚度;因此,觀察研磨墊不作修整 (Conditioning)時之移除率變化情形也是本論文重點。

(4) 研磨漿料(Slurry):

研磨漿料(Slurry)主要由微細研磨顆粒與化學溶液組成。研磨顆粒的種類、大小、形狀、PH 值與溫度等因素都會對研磨的效果產生影響,亦有許多人從事研磨漿料(Slurry)調配之研究。

2.2 熱場發射掃描式電子顯微鏡介紹

熱場發射掃描式電子顯微鏡簡稱 TFSEM[8], 機台外型如圖 2.3。

其量测方式可分為二種:

SEI(二次電子影像)掃描式電子顯微鏡電子槍產生電子束後,

經電子光學系統,使電子數縮小,再照射試片表面,而激發二次電子。 這些二次電子被偵測器偵測後,再經由訊號處理放大送到 CRT,即可 看到表面形貌。

BEI (反射電子影像)電子束照射試片表面後,亦會激發反射電子(也較背向散設電子)。試片中平均原子序越高的區域,是放出的 反射電子越多,因此利用反射電子影像來觀察表面平滑無明顯特徵, 而卻有微區化學組成差異的試片特別有用。其形貌觀測圖如圖 2.4。 其量測出之圖型如圖 2.5

分析技術特性:

- (1) 解析度: 1.5nm at 25kev(SEI); 3nm at 15kev (BEI)。
- (2) 放大倍率: 20~300000 倍。

(3) 限制:粉末、揮發性物質、磁性物質、高分子無法觀測。

(4) 缺點:電荷蓄積效應,樣品需導電性良好,對導電性差的 樣品,可度上導電性佳的金屬於表層,增加其導電性。

2.3n&k-薄膜测厚儀介紹

n&k-薄膜測厚儀[8]機台外型如圖 2.6。

量測方式為,以光線打在晶圓上,藉由光線的折射及反射,量測 出晶圓各層的厚度,再將資料送回電腦之 n&k 程式,並加以整理顯 示。分析隻晶圓基層為 si,可量測單層至多層,N、K 量測的基礎數 值包含:Π-VI化合物;Ⅲ-V化合物;Al 化合物;Ge 化合物;玻璃;金 屬;Nirtrides;Oxides;Oxynitrides;Silicides;Si;Si 化合物;混合 物......等。

前述之n&k-薄膜測厚儀為舊廠之機台,現新廠已有一台新的 NK1500-薄膜厚度分析儀,其可選定固定點來量測(舊廠之n&k-薄膜 測厚儀機需用手移位抓點),故較舊廠機台更為精準且方便其機台外 型如圖 2.7。

2.4 化學機械研磨基本參數

由1.1小節可知,影響 CMP 的參數包括:(1)機械作用;(2)化 學作用;分別敘述如下:

機械參數主要有[1]:

- (1) 晶圓載具轉速(Carrier Speed)。
- (2) 研磨平台轉速(Platen Speed)。
- (3) 晶片施壓大小(Down Force)。
- (4) 磨漿之供料速率(Slurry Flow Rate)。
- (5) 研磨墊清洗頻率、時間、速度(Pad Conditioning Frequency, Time, Velocity)。
- (6) 研磨墊壓縮性(Pad Compressibility)。
- (7) 研磨墊彈性模數(Elastic Modulus)。
- (8) 研磨墊硬度、厚度(Pad Hardness / Thickness)。
- (9) 抛光擺動模式(Polish Oscillation Pattern)。
- (10) 背壓(Back Pressure)。
- (11)薄膜應力(Film Stress)。
- (12)薄膜硬度(Film Hardness)。
- (13)摩擦力(Frictional Forces)...等等。

化學參數主要影響來自研磨漿料(slurry),主要參數有[1]:

- (1) 研磨漿料之成分(Slurry Composition)。
- (2) 研磨漿料之顆粒大小分佈(Slurry particle size distribution)。
- (3) 研磨漿料之 PH 值。
- (4) 研磨漿料之黏滯性(Viscosity)。
- (5) 研磨粉體之硬度(Abrasive Hardness)。
- (6) 研磨漿料之顆粒懸浮穩定度(Stability of the abrasive suspension)。
- (7) 研磨墊材質(Pad composition)。
- (8) 晶圓薄膜之成分(Film Composition) ... 等等。

由以上可知,影響 CMP 之原因與參數之間的關係是相當複雜

的,其中之研究也是相當眾多。1896

此外,機台本身的設計與製造也會直接或間接的影響到晶圓的平 坦度。如晶圓載具一般來說有兩類抓取晶圓的方法,一類為研磨頭以 真空吸覆晶圓的真空吸附抓取法(Vacuum Mounting),另一類為研磨 頭表面以製造成凹槽來抓取晶圓的研磨頭抓取法(Carrier Mounting)。因此,若晶圓載具在抓晶圓的時候不平坦,則一定會影 響到晶圓的平坦度。

另外,研磨時加壓,也與機台的設計及製造結構有關,而加壓的 目的在於研磨的時候,使壓力均勻分布在晶圓的表面,用以避免研磨 後產生晶圓周圍與晶圓中間不平坦的移除問題。

再加上對於不同的研磨材料,必須使用不同的研磨漿料,而如何 控制研磨漿料的成分及濃度,也就成為一極需解決的問題。故不同的 研磨材料,其主要的猜數就有所不同,而參數間也會產生交互作用, 亦增加 CMP 製程的困難度,控制參數,進而得到最大的研磨效益也就 成為值得研究的主題之一。



化學機械研磨機台在研磨不同的材料時,必須使用不同的研磨漿 料,如:二氧化矽需用 PS2515+DI Water 來研磨,銅需用三氧化二 鋁 3%+硝酸 2%+DI Water 來研磨……等,但是目前卻沒有可用以同 時研磨二氧化矽和銅的研磨漿料。其中銅的研磨漿料可以研磨二氧化 矽,而返之則否,因此工程師建議以銅的研磨漿料的配方加以改變比 例(其中由於機台耐酸性的問題,必須將硝酸的濃度配置在 7%以下, 以免造成機台毀損),使之可以在研磨銅及二氧化矽時的移除率可以 極為接近,配置流程圖如圖 2.8。

第三章 實驗設計法與模型建立

3.1 實驗設計法

任何領域的研究人員進行實驗,目的是想得到有關特定過程 或系統的一些訊息。一個實驗(Experiment)就是一個試驗或一系列的 試驗,而在這些試驗中,對於特定的試驗過程或系統的輸入變數,我 們故意變動它們的值,使得我們可以觀察到或辨認出輸出值的變動原 因。一般而言,實驗是用來研究製程或系統的表現的,而製程或系統 可以用圖 3.1 來表示。我們可以將製程想像成是設備、方法、人和其 他資源的一個組合,透過這個組合,可以將一些輸入轉換成輸出(可 以是一個或多個可觀測的反應值)。而製程變數中有一些是可控的, 以X₁,X₂,...,X_p表示,有些是不可控的,以Z₁,Z₂,...,Z_q表示。則實驗的目 的可能包含下列幾點:

- 1. 決定哪些變數對反應 y 來講最具影響力。
- 決定這些具有影響力的 X 的值使得 y 幾乎永遠都是在所想要的 目標值附近。
- 3. 決定這些具有影響力的 X 的值使得 y 的變異較小。
- 4. 決定這些具有影響力的 X 的值使得不可控變數 Z₁, Z₂,..., Z_a 的影

響極小。

實驗設計法是探討實驗進行的方式以及對實驗觀測值的解析,以 提高獲得情報的效率且使實驗成本最低的一門學問。在此用有限的資 源得出最好的結果,這對我們是相當有幫助;也就是利用事前考慮周 詳的資料蒐集程序來進行實驗,而使得實驗結果的再現性很高、配置 實驗的伸縮性大、實驗次數較少、實驗配置容易與解析方法較為簡便 的方法。為達成以上之目標,我們必須採用科學的途徑來規劃實驗過 程,使得利用統計方法來分析的合理資料可被蒐集,而得到正確的結 論;當資料牽涉到實驗誤差時,統計方法是分析的唯一客觀途徑[6]。 要以統計方法來設計並分析一個實驗,相關人員必須在事前就對 到底要研究什麼、資料要如何蒐集;及定性瞭解資料要如何分析等事 情有一個清晰的概念。如表 3.1。

在這整個設計實驗的過程裡,還必須注意三個重要基本實驗設計 原理,即重複(replication)、隨機化(randomization)、 和區集劃 分(blocking)。

所謂重複,我們指基本實驗的重複再作,重複有兩個重要的性 質。一、它允許實驗者可以估計實驗誤差的變異數而這個誤差變異數 的估計值就成為判斷所觀察到的資料中的差異是否為統計上顯著的 基本衡量單位。二、如果樣本平均值(y)是用來估計實驗中因子效 應,則重複使得實驗者可以得到更精確的效應估計值。

隨機化是實驗設計中使用統計方法的背後基石。所謂的隨機化, 我們是指實驗材料的配置及各個試驗的進行順序二者。統計方法要求 觀測值(或誤差值)為分配獨立的隨機變數。隨機化的過程通常可以確 保這個假設成立。實驗透過適當的隨機化,亦有助於(平均消除 (average out))可能出現的外來因子的干擾。一般而言,隨機實驗 順序可由亂數產生器(random number generator)產生。

區集劃分是一個設計技巧,它用於眾多因子比較時,改善比較的 精確度。區集劃分常用於減低或者消除干擾因子(nuisance factors) 形成的變異。干擾因子影響實驗結果,但是這種影響並不是我們所關 心的。一般而言,區集是一組相對均齊的實驗條件,干擾因子的每一 個水準為一個區集。最後,實驗者基於統計設計,將觀察值分為若干 組,每一組在一個區集實驗。

以上所提的三個實驗設計的基本原理是每一個實驗必須包含的 重要部份[9]。

16

3.2 最小平方誤差法原理

最小平方誤差法[11]是用來估計多元線性迴歸模型裡迴歸係數 的方法。其為輸入數值 X 以及輸出數值 Y 之間的以多項是呈現的變數 關係。一般而言,這些關係的係數是未知的。假設一個有 n 個變數因 子的二階模型,則如下:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i x_i + \sum_{i=1}^n \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ii} x_j x_j + \delta$$

其中 y 為輸出值, x 為輸入值, β 為關係函數的係數, 而 δ 則為 誤差值。



3.3 建立化學機械研磨系統模型

在建立模型前,在經由賴明志工程師建議之下,壓力設定在 2~6psi之間、轉速設定在20~40rpm之間、而流速設定在 150~250m1/min之間,其中壓力以2psi為弱、4 psi為中、6 psi為 強,轉速以20rpm為弱、30 rpm為中、40 rpm為強,流速以150m1/min 為弱、200m1/min 為中、250m1/min 為強,以此為輸入再以 MATLAB7.0 建立模型。如圖 3.2。



第四章 實驗概況

4.1 實驗設備

此實驗於國立交通大學內之國家奈米實驗室(National Nano Device Laboratories, NDL)進行實驗,並使用內部之機台,設備簡介如下:

(1) 化學機械研磨系統 (無塵室 10K 級)

本機台(圖2.1)廠牌為美國 Westech Model 372M,該機台 為研磨六吋的晶片,研磨襯墊型號為 IC 1400,使用之研磨液在 研磨二氧化矽時為 PS2515(Planar Sorf 2515)是一種鹼性研磨液, 全名二氧化矽化學機械研磨液,其主要成分有:二氧化矽、氫氧 化鉀和水;而研磨銅時則使用三氧化二鋁、硝酸和水配置出之研 磨液。

(2) 化學機械拋光後清洗機 (無塵室 10K 級)

本機台為美國 Solid State Equipment Corporation (SSEC)公司 所生產,型號為 50 Evergreen Cleaner 機台,以 DI water 清洗然後 高速旋乾研磨後之晶圓。

(3) 熱場發射掃描式電子顯微鏡(非無塵室)

本機台(圖 2.3)量測方式如第二章所述,可量測晶圓的純 粹厚度(由於折射之原因,n&k 無法樑側較厚之金屬厚度),但 由於必須先行破片,故量測完之晶圓無法繼續使用。

(4) n&k 薄膜測厚儀(無塵室 10 級)

本機台(圖 2.5)是利用光學波長的原理來量出薄膜之厚度, 具有 3 個光學頭,機器型號為 n&k analyzer 1200,可量測 6 吋以 下,單/雙層之晶圓,其缺點為量測點必須用手移動,因此研磨 前後之量測,不易取到同一點,而取點法如圖 4.1。

(5) NK1500-薄膜厚度分析儀(無塵室 100 級)

本機台(圖2.6)量測原理同前述之機台,但由於可以使用 機台鎖定量測點,故較前述之機台準確。本機台未近數月新開放 之機台,開放前敝人實驗已有部分完成,固本論文同時使用新舊 2種機台。

4.2 實驗材料

本實驗所使用之材料如下:

(1) 矽晶片(p-type)

本實驗由於數據需要甚多,因此全程使用約 55 片晶圓,其 中 34 片製成樣片,6 片製成純銅之控片,剩餘晶圓則製成純二 氧化矽之控片。由於量測樣片及純銅之控片必須使用 TFSEM 機台且必須破片,故無法在使用;而二氧化矽之控片則可重複 利用,因此使用較少。 (2)研磨液 二氧化矽之控片使用 PS2515(Planar Sorf 2515)溶液以一比 1895 一的比例來與去離子水(DI Water)混和調配來研磨,而控片之研 磨則使用,原用以研磨銅之研磨液:三氧化二鋁、硝酸和去離

子水以不同比例調配而成。

(3) 晶圓夾

市面上之鐵氟龍晶圓夾

(4) 晶圓盒

用以避免造成晶圆污染。
4.3 實驗規劃及步驟

在研磨前之實驗步驟(圖1.3)完成後,先取一部份之二氧化矽 控片,以完全相同之實驗參數連續研磨,接著量測移除厚度以取得二 氧化矽之控片的移除率下降數據,並做成公式。而後取兩種不同之控 片,在相同之物理參數下,改變研磨液中三氧化二鋁以及硝酸的濃度 研磨之,並個別取得移除率數據,並將這些數據計算成公式,並找出 可使同級二氧化矽有極為接近之移除率之濃度配方。再取7片左右之 樣片,以此配方與之前二氧化矽控片相同條件下連續研磨,並取得樣 片之移除率下降數據,並做成公式。最後再以調配之研磨液,在不同 參數下進行研磨,並取得移除率數據。

其中,無論是銅之控片或樣片均需使用 TFSEM 來量測,因此均需破片,故在研磨之前,均必須留下一片不研磨,作為研磨前後之移除厚度取得之基礎厚度。

由於一般確定研磨墊之磨擦力是否過低時,是使用研磨二氧化矽 之研磨液來研磨控片,故本實驗在以不同參數研磨二氧化矽之控片時 所使用之研磨液,仍是原本的 PS2515 溶液以一比一的比例來與去離 子水調配而成。

第五章 各模型製作及比較

5.1 研磨漿料的配置

由前章所述之實驗方式,所取得的數據如表 5.1。

使用數據即可求出,硝酸對銅的移除厚度方程式為: R=140.75 t^3 -1266.75 t^2 +3669.66t-147.00 而 Al₂O₃對銅的移除厚度方程式為: R=88.91 t^3 -400.1 t^2 +573.26t+2993.93 另外,硝酸對 SiO₂的移除厚度方程式為: R=9.31 t^2 -45.22t+77.03 而 Al₂O₃對 SiO₂的移除厚度方程式為:

 $R=11.95t^2 - 45.63t + 67.26$

再由這些方程式相互比較,其中 Al₂O₃ 對銅及 SiO₂ 的移除厚度方程比較 之圖型如圖 5.1,而硝酸對銅及 SiO₂ 的移除厚度方程式比較圖如圖 5.2,且硝酸濃度不可以超過 7%為原則,則可求出,當 Al₂O₃ 的濃度為 1%且硝酸濃度為 0.616%左右時,銅與 SiO₂ 的移除率是最為接近的,因 此以此為配方調配出樣片所需之研磨液。 5.2 移除率下降率的模型建立

由前章所述,所得之實驗數據如表 5.2。

由於我假設移除率的下降方程式為一階線性方程式:

y = ax + b

因此可將研磨SiO,的移除率下降方程式設定為:

RR = -0.092t + 9.7869

其圖形如:圖5.3。圖中之點會與圖中斜線幾乎密合的原因可能為, 此移除率下降斜率與移除率本身相比過小,故不容易形成較偏離之 點。 而研磨 Cu 的移除率下降方程式則為: RR = -0.116t + 2.8748

其圖形如:圖5.4。

其中 RR 為移除率, t 為研磨片數。

5.3 SiO₂控片的移除率模型建立

由前章所述之實驗方式,由於晶圓數目偏少,且重複使用,並不 會影響其移除率,故重複使用。其中實驗參數如表 5.3,而不同參數 之移除數據如表 5.4~表 5.30。

由於本實驗是經由連續研磨操作,中間並未使研磨墊之摩擦係數回覆,因此必須以前述之移除率下降公式加以修正,修正後所得之數 據方正確數據。

以這些數據,經由最小平方法,於 MATLAB7.0 建立之模型為: RR = 2.28281F + 0.10372S + 0.00988R + 0.05756F * S + 0.00006S * R -0.00132F * R - 0.26817F² - 0.00368S² - 0.0000001R² - 7.31771 -0.092t + δ 在此中 RR 為移除率、F 為正壓力、S 為轉速、R 為研磨液流速而 t 為 研磨之片數。

5.4 樣片的移除率模型建立

由前章所述之實驗方法,搭配新配之研磨液,再調整實驗參數如

表 5.31,所得之實驗數據如表 5.32~表 5.58。

與SiO₂控片情形相同,本實驗是經由連續研磨操作,中間並未使 研磨墊之摩擦係數回覆,因此必須以前述之移除率下降公式加以修 正,修正後所得之數據方為正確數據。

以這些數據,經由最小平方法,於 MATLAB7.0 建立之模型為: RR = 0.22706F + 0.00041S - 0.00658R + 0.00151F * S + 0.00024S * R $-0.00002F * R - 0.02097F^2 - 0.00034S^2 + 0.00005R^2 - 1.02829 - 0.116$ $+\delta$

在此中 RR 為移除率、F 為正壓力、S 為轉速、R 為研磨液流速而 t 為

研磨之片數。



5.5 模型之適配度之計算

每個不同的模型,都有各自的適配度,也就是此模型所計算出之輸出值,與實際實驗輸出值之擬合度[12]。而其相關公式即為:

$$\sum (Y_t - \overline{Y})^2 = \sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2 + \sum (\hat{Y}_t - \overline{Y})^2$$

其中 Y_i 為實驗輸出值、 \overline{Y} 為實驗輸出值之平均而 \hat{Y}_i 則為模型的輸出 值。此式可寫成: SST = SSE + SSR

 $SST = \sum (Y_t - \overline{Y})^2$ 稱為總平方和, $SSE = \sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2$ 稱為殘差平 方和, $SSR = \sum (\hat{Y}_t - \overline{Y})^2$ 稱為迴歸平方和, 其總誤差 $Y_t - \overline{Y}$ 之分割 圖是如圖 5.5。若X與Y關係越好,則SSR在SST中所佔比例越大, 可用迴歸解釋的誤差除以總誤差得到相關程度的測度: $R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$ 其中 R^2 即為所謂之適配度。

由此可知,適配度越接近1越好,而此方程式中之Y,即為移除 率模型中之 RR。在帶入公式計算後得知,SiO₂之控片的適配度為 0.93541 即為 93.5%,而樣片的適配度為 0.95794 即為 95.8%,由此 是配度可得知此二模型均為非常接近實驗之模型。

5.6 不平坦度之研究

本實驗的不平坦度,SiO₂之控片的部分可由表 5.4~表 5.30 得 知,大約都是在 17.5Å上下,其中有幾個插平均值較遠,其原因可能 為化學機械研磨機台本身的誤差,或量測時使用之機台維舊型的 n&k-薄膜測厚儀,由於點比需使用手移動來量測,無法與研磨前量測 完全同一點,因此造成有所誤差。其不平坦度圖形如圖 5.6。

以這些數據,經由最小平方法,於MATLAB7.0建立之模型為:

NPI = 0.00007F + 0.00008S + 0.00002R + 0.00001F * S - 0.0000003S * R-0.000002F * R + 0.00004F² - 0.000001S² + 0.00000001R² + 17.8529 + δ 在此中 NPI 為移除率、F 為正壓力、S 為轉速而 R 為研磨液流速。

而樣片的部分可由表 5.32~表 5.58 得知,大約都在 23Å 上下, 其中差平均較遠的,其原因可能為化學機械研磨機台本身的誤差,或 量測時使用 TFSEM 必須先破片,但是無法取到完全正確的點。其不平 坦度圖形如圖 5.7。

以這些數據,經由最小平方法,於MATLAB7.0建立之模型為:

而兩種晶圓之不平坦度由公式可得知,除了常數項為二位數外, 其餘皆為小數點後四位以後,相比之下之值極小,故可忽略。

因此可得知不平坦度與改變之變數之關係極小,因此可以忽略不 計。



5.7 模型間關係概況

由前述之雨大模型可得知,由於有三種不同的變換參數,而參數 間又互相影響,再加上移除率的下降,造成有十種以上不同且無方程 式關係的係數存在,因此無法單純只以T,之方程式來帶入兩者間之關 係,無論是幾階方程均無法以單一變數來連接兩者間之關係。但是, 並非無法由研磨樣片時之移除率來推算控片之移除率,可將參數及樣 片移除率帶入樣片模型,以求出研磨率下降之片數 t 之值,再將 t 及 參數帶回控片模型即可得知此時控片之移除率以及是否須手動用刷 子刷研磨墊,恢復研磨墊的摩擦率,或者更換新的研磨墊,進而節省 晶圓之消耗。

第六章 結論及未來展望

由實驗結果可以得知,由於有三個輸入值,且各輸入值均會互相 影響,因此最後建立出之模型會如此長,並且得知無法只用T_f方程之 單一變數取得不同模型之間的關係,並且可以得知晶圓材料不同,及 本實驗所控制的變數,影響不平坦度的機會極小,可以忽略不計。

由於兩種不同晶圓的模型都已製作,還是可以使用研磨樣片時之 移除率帶入模型,求出研磨片數t,在以之帶回控片模型,即可求出 當時控片之移除率,因而得知研磨墊之狀況,進而達成節省控片之目 的。

本實驗在未來有幾點可以發展如下

(1)SiO₂之控片以及Cu之控片,均有各自的研磨液可以使用, 而讓對方使用時之移除率卻出奇的低,又因為SiO₂所使用之研 磨液,PS2515是已經調配完成之研磨液,並無法分離重配,故 本實驗選用可以變換成分比例之Cu用研磨液來調配心研磨 液,也造成樣片之移除率大為降低,希望將來能調配出能同時 研磨SiO₂以及Cu且有高移除率之研磨液。

(2)在本實驗中使用最主要可以調整的三項參數:壓力、轉速 以及研磨液流速加以調整,其餘物理方面之參數也不容易完整 調整,希望將來能找出與化學參數如:研磨漿料相關參數、溫度……等相關參數有關之移除率模型,使晶圓的移除率模型更加完整。

(3)而在國外的論文中,CMP機台都有導入即時監測厚度的干 涉儀裝置,如果未來CMP機台有此裝置,不僅可以作每批片的厚 度控制外;還可以作每秒作厚度控制或不平坦度控制;另外,如 果可以即時知道厚度,就可以即時帶入公式,並得知研磨墊的狀況。但由於國家耐米實驗室沒有在線厚度偵測器,只能將此晶圓 磨完後帶去量測機台裡面量測。因此,假如有在線厚度量測, RTMS 與本研究之內容可以相輔相成;但是由於NDL本身並沒有 這樣的設備;另一方面也是因為實驗片數之稀少,而不像大廠裡 都是隨時隨地在RUN片,因此運用困難。但是,假如將本實驗 與 RTMS 配合在一起給大廠晶圓片數多的情況下使用,就是一個 更完善的研磨墊確認系統了。

32

參考文獻

- [1] 薛木坤,"應用模糊類神經網路於銅膜化學機械研磨之批次製程 控制",碩士論文,國立交通大學機械工程研究所,2004。
- M. A. Fury, "Chemical Mechanical Planarization of Aluminum-Based Alloys for Multilevel Metallization", Solid State Technology, Vol.20, P.61, 2000.
- [3] F.G. Shi and B. Zhao. Fundamentals of CMP for IC manufacturing: Recent progress. In Proceedings of 5th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, pages 113-115, 1998.
- [4] S.S.P. Rao, J. Stefani, S. Comstock, J. Larsen, B. Paquette, and M. Wang. Run-to-run process control of oxide cmp using integrated metrology. In The Ninth International Symposium on Semiconductor Manufacturing, pages 411-414, 2000.
- [5] W. Campbell. Model Predictive Run-to Run Control of Chemical Mechanical Planarization. Ph.D. Dissertation, Univ. Texas at Austin, 1999.
- [6] 周孟賢, "化學機械研磨時控製程參數最佳化技術", 碩士論

文,國立中興大學機械工程研究所,1999。

- [7] 林柏勳, "含時間估測器之類神經網路式 Run-to-Run 製程控制器設計及其在銅製程 CMP 之應用",碩士論文,國立中興大學機械工程研究所,2003。
- [8] 國家奈米實驗室網頁。
- [9] Douglas C.Montgomery , <u>Design and Analysis of Experiment</u> , 5th Edition
- [10] Chadi El Chemali, James Moyne and Kareemullah Khan, "Multizone uniformity control of a chemical mechanical polishing processutilizing a pre- and postmeasurement strategy" 2000 American Vacuum Society, J. Vac. Sci. Technol. A 18.4., Jul-Aug

2000.

- [11] 實驗設計與分析, Design and Analysis of Experiments 5/e 原著
 Montgomery 黎正中、陳源樹 編譯
- [12] 時間數列分析與預測 三版, Time Series Analysis and Forecasting林茂文 著
- [13] 劉柏聖, "Run to Run prediction and control of ADI CD", 碩士論文,國立中興大學機械工程研究所,1999。



 問題的認知及陳述 因子、水準及範圍的選擇 反應變數的選擇 實驗設計的選擇 , 實驗設計的選擇 , 執行實驗 , 資料的統計分析 , 結論與建議
*實務上,步驟2和3通常是同時完成,或順序顛倒。

表 3.1 實驗設計步驟大綱

Al_2O_3 ,硝酸比例	2%, 2.8%	2%,5.6%	2%, 1.4%	4%,2.8%	1%, 2.8%
二氧化矽	23.823	73.039	41.114	111.878	33.588
鉰	3251.33	3271.667	2396.667	4575.667	3256

表 5.1 研磨液不同比例之移除厚度(Å)



	1	2	3	4	5	6	7
SiO ₂	587.22	579.35	571.09	570.64	555.96	544.21	542.93
Cu	5.75	5.68 🌍	5.60	5.53	5.31	5.12	4.98

表 5.2 連續研磨之移除厚度 (Å)

研磨墊	Primary Pad
Time	60 sec
Down Force	2~6 psi
Back pressure	1/2 Down Force
Platen speed	20~40 rpm
Carrier Speed	20~40 rpm
Slurry	PS2515+DI Water(1:1)
Flow rate	150~250 ml/min

表 5.3 SiO2之控片實驗固定參數值

第01片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4437.1	4405.66	4415.39	4438.81	4430.18	4449.88	4450.84	4435.74	4446.27
研磨後	4234.6	4195.9	4198.79	4213.13	4222.35	4230.93	4228.95	4224.16	4227.5
研磨厚度	202.5	209.76	216.6	225.68	207.83	218.95	221.89	211.58	218.77
平均移	除率		3.580667	,	不平	坦度		13.20002	
修正後之	移除率		3.580667	1					

表 5.4 模型 DF=4 psi, SP=20 rpm, FR=150m1/min

第02片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4469.76	4473.67	4512.3	4451.48	4448.73	4466.08	4436.5	4457.16	4425.33
研磨後	4454.85	4463.66	4462.33	4423.66	4432.54	4446.57	4437.16	4457.15	4436.26
研磨厚度	14.91	10.01	49.97	27.82	16.19	19.51	-0.66	0.01	-10.93
平均移	除率		0.23487		不平	坦度		13.47743	;
修正後之	移除率		0.327144	ARTER.	aller,				

表 5.5 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=150m1/min E S

				the second second	and the second				
第03片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4451.91	4451.33	4441.43	4443.58	4434.09	4441.25	4454.99	4458.12	4455.76
研磨後	4171.3	4191.97	4188.17	4152.85	4126.04	4196.77	4188.63	4193.61	4190.81
研磨厚度	280.61	259.36	253.26	290.73	308.05	244.48	266.36	264.51	264.95
平均移	除率		4.504278	m	不平	坦度		22.48096)
修正後之	移除率		4.688824						

表 5.6 模型 DF=6 psi, SP=20 rpm, FR=150m1/min

第04片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4465.39	4465.38	4457.06	4447.08	4456.01	4463.4	4450.83	4459.36	4435.5
研磨後	4451.62	4459.41	4459.75	4451.67	4435.11	4451.28	4440.51	4435.98	4421.69
研磨厚度	13.77	5.97	-2.69	-4.59	20.9	12.12	10.32	23.38	13.81
平均移	除率		0.172204	_	不平	坦度		11.99628	
修正後之	移除率		0.449023	;					

表 5.7 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

第05片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4444.94	4457.56	4438.02	4446.55	4436.02	4440.52	4414.41	4423.92	4443.93
研磨後	4116.88	4120.54	4123.71	4098.2	4075.97	4094.76	4085.07	4129.21	4058.21
研磨厚度	328.06	337.02	314.31	348.35	360.05	345.76	329.34	294.71	385.72
平均移	除率		5.635778	5	不平	坦度		22.8496	
修正後之	移除率		6.00487						

表 5.8 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

第06片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4481.95	4450.66	4427.62	4454.41	4435.51	4473.04	4483.12	4462.8	4457.08
研磨後	3930.93	3933.15	3911.64	3897.76	3875.36	3953.75	3965.69	3896.38	3886.45
研磨厚度	551.02	517.51	515.98	556.65	560.15	519.29	517.43	566.42	570.63
平均移	除率		9.027926		不平	坦度		29.1872	
修正後之	移除率		9.489292	ALLER	aller,				

表 5.9 模型 DF=6 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

			and the second second		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
第07片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4470.92	4458.09	4 <mark>448</mark> .44	4476.69	4474.6	4499.15	4499.88	4473.63	4457.01
研磨後	4449.92	4438.29	4427.72	4438.61	4403.11	4445.41	4479.61	4433.75	4415.21
研磨厚度	21	19.8	20.72	38.08	71.49	53.74	20.27	39.88	41.8
平均移	除率		0.605148	34	不平	坦度		20.48667	,
修正後之	移除率		1.158787	1					

表 5.10 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=250m1/min

第08片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4475.38	4489.97	4476.23	4458.37	4467.21	4474	4447.17	4472.65	4472.25
研磨後	4263.57	4288.98	4261.6	4246.13	4261.59	4257.87	4237.58	4268.87	4255.88
研磨厚度	211.81	200.99	214.63	212.24	205.62	216.13	209.59	203.78	216.37
平均移	除率		3.502148	5	不平	坦度		13.54998	1
修正後之	移除率		4.14806						

表 5.11 模型 DF=4 psi,SP=20 rpm,FR=250m1/min

第09片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4482.81	4498.88	4488.36	4476.79	4435.76	4475.85	4480.15	4490.73	4503.05
研磨後	4155.93	4155.67	4137.63	4127.84	4103.92	4158.1	4133.79	4151.1	4169.1
研磨厚度	326.88	343.21	350.73	348.95	331.84	317.75	346.36	339.63	333.95
平均移	除率		5.628333	;	不平	坦度		18.76513	;
修正後之	移除率		6.366519						

表 5.12 模型 DF=6 psi,SP=20 rpm,FR=250m1/min

第10片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5034.75	5035.34	5033.78	5033.57	5030.9	5036.71	5035.61	5032.38	5030.93
研磨後	5009.74	5004.71	4947.29	5004.76	5015.23	4981.48	5002.13	5013.73	5021.8
研磨厚度	25.01	30.63	86.49	28.81	15.67	55.23	33.48	18.65	9.13
平均移	除率		0.561296		不平	坦度		21.50246	
修正後之	移除率		1.391755	ARTER.	aller,				

表 5.13 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=250m1/min E S

第11片	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
研磨前	5038.73	5039.25	5038.53	5036.69	5038.67	5038.57	5039	5038.41	5035.7			
研磨後	4702.71	4682.29	4675.05	4692.19	4699.88	4677.57	4698.35	4695.28	4692.51			
研磨厚度	336.02	356.96	363.48	344.5	338.79	361	340.65	343.13	343.19			
平均移	除率		5.792074		不平	坦度		9.437105				
修正後之	移除率		6.714806									

表 5.14 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=250m1/min

64 1 0 I I		_	2	,	_	-	_	2	0
第12片	1	2	3	4	5	6	1	8	9
研磨前	5047.74	5052.77	5054.94	5044.86	5040.24	5057.28	5058.14	5044.33	5040.35
研磨後	4461.46	4441.19	4446.07	4460.91	4467.72	4474.61	4425.63	4460.6	4420.64
研磨厚度	586.28	611.58	608.87	583.95	572.52	582.67	632.51	583.73	619.71
平均移	除率		9.966333	;	不平	坦度		17.70962	
修正後之	移除率		10.98134	-					

表 5.15 模型 DF=6 psi,SP=40 rpm,FR=250m1/min

第13片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5022.66	5024.26	5023.89	5019.85	5017.01	5023.81	5022.97	5020.38	5019.99
研磨後	4800.38	4768.94	4778.67	4802.09	4793.46	4813.16	4814.12	4799.02	4809.55
研磨厚度	222.277	255.317	245.217	217.757	223.547	210.646	208.846	221.357	210.437
平均移	除率		3.732227	,	不平	坦度		14.47029)
修正後之	移除率		4.839505	5					

表 5.16 模型 DF=6 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5016.28	5017.37	5017.65	5013.78	5011.17	5017.71	5017.91	5013.78	5010.29
研磨後	4640.78	4644.69	4683.32	4622.50	4619.75	4637.10	4607.52	4628.18	4596.35
研磨厚度	375.494	372.674	334.324	391.274	391.414	380.604	410.384	385.594	413.934
平均移	除率		6.39944		不平	坦度		23.60837	
修正後之	移除率	7.	59899092	26	Ulter,				

表 5.17 模型 DF=6 psi, SP=30 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
研磨前	4234.6	4195.9	4 <mark>198</mark> .79	4213.13	4222.35	4230.93	4228.95	4224.16	4227.5	
研磨後	4187.77	4123.66	4153.93	4183.74	4175.41	4189.8	4208.11	4173.55	4188.36	
研磨厚度	46.8313	72.2413	44.8613	29.3 913	46.9413	41.1313	20.8413	50.6113	39.1413	
平均移	除率		0.72486	34	不平	坦度		13.49286)	
修正後之	移除率		1.83213							

表 5.18 模型 DF=2 psi, SP=30 rpm, FR=150m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4454.85	4463.66	4462.33	4423.66	4432.54	4446.57	4437.16	4457.15	4436.26
研磨後	4147.01	4167.45	4175.7	4127.13	4171.51	4143.24	4102.25	4165.48	4163.13
研磨厚度	307.838	296.208	286.631	296.528	261.028	303.328	334.911	291.668	273.128
平均移	除率		4.91276		不平	坦度		19.84166	5
修正後之	移除率		6.11231						

表 5.19 模型 DF=4 psi,SP=30 rpm,FR=150m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4171.3	4191.97	4188.17	4152.85	4126.04	4196.77	4188.63	4193.61	4190.81
研磨後	3736.49	3749.37	3745.77	3717.99	3707.74	3763.21	3764.93	3774.44	3785.93
研磨厚度	434.814	442.604	442.403	434.864	418.304	433.56	423.704	419.174	404.884
平均移	除率		7.14031		不平	坦度		11.87681	
修正後之	移除率		8.43213						

表 5.20 模型 DF=6 psi, SP=30 rpm, FR=150m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4476.14	4487.03	4502.57	4504.28	4511.64	4473.63	4485.41	4465.33	4433.04
研磨後	4451.62	4459.41	4459.75	4451.67	4435.11	4451.28	4440.51	4435.98	4421.69
研磨厚度	24.517	27.62	42.817	52.607	76.527	22.347	44.904	29.347	11.347
平均移	除率		0.6129		不平	坦度		18.49163	
修正後之	移除率		0.77123	and	Ulter,				

表 5.21 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
研磨前	4116.88	4120.54	4123.71	4098.2	4075.97	4094.76	4085.07	4129.21	4058.21	
研磨後	3958.66	3982.74	3993.69	3950.5	3920.58	3961.68	3932.67	3978.42	3910.19	
研磨厚度	158.219	137.799	130.021	147.699	155.389	133.079	152.398	150.789	148.019	
平均移	除率		2.43594	. The	不平	坦度		9.417545	i	
修正後之	移除率		3.91231							

表 5.22 模型 DF=4 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	3930.93	3933.15	3911.64	3897.76	3875.36	3953.75	3965.69	3896.38	3886.45
研磨後	3877.96	3918.88	3896.82	3866.26	3834.64	3904.45	3919.58	3853.85	3840.58
研磨厚度	52.9653	14.2653	14.8201	31.4953	40.7153	49.2953	46.1066	42.5253	45.8653
平均移	除率		0.63259		不平	坦度		13.53839)
修正後之	移除率		2.20123						

表 5.23 模型 DF=2 psi,SP=30 rpm,FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4449.92	4438.29	4427.72	4438.61	4403.11	4445.41	4479.61	4433.75	4415.21
研磨後	4146.86	4140.26	4187.11	4142.04	4094.56	4170.61	4180.95	4126.7	4100.09
研磨厚度	303.063	298.033	240.613	296.571	308.553	274.803	298.661	307.053	315.123
平均移除率		4.89033			不平	坦度		21.53221	
修正後之	移除率		6.55124						

表 5.24 模型 DF=4 psi, SP=30 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4305.86	4320.97	4296.41	4319.61	4326.19	4306.83	4297.56	4308.86	4316.76
研磨後	4263.57	4288.98	4261.6	4246.13	4261.59	4257.87	4237.58	4268.87	4255.88
研磨厚度	42.288	31.993	34.808	73.478	64.598	48.963	59.977	39.988	60.878
平均移除率		0.852		不平	坦度		13.71808		
修正後之移除率 0.90		0.90123	antill	aller,					

表 5.25 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	_ 4	5	6	7	8	9	
研磨前	4155.93	4155.67	41 <mark>37</mark> .63	4127.84	4103.92	41 <mark>58.</mark> 1	4133.79	4151.1	4169.1	
研磨後	3867.79	3867.26	3868.78	3872.87	3860.07	3847.14	3810.89	3897.51	3925.44	
研磨厚度	288.14	288.414	268.85	254.97	243.849	310.96	322.9	253.59	243.66	
平均移除率		4.56667	"m	不平	坦度		27.48695			
修正後之移除率		6.41213								

表 5.26 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5009.74	5004.71	4947.29	5004.76	5015.23	4981.48	5002.13	5013.73	5021.8
研磨後	4536.45	4551.69	4490.63	4532.02	4535.68	4498.52	4564.67	4541.3	4589.33
研磨厚度	473.289	453.019	456.658	472.739	479.549	482.961	437.459	472.429	432.469
平均移除率 7.7135			不平	坦度		17.26958			
修正後之移除率 9.651		9.65123							

表 5.27 模型 DF=6 psi,SP=40 rpm,FR=200m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4702.71	4682.29	4675.05	4692.19	4699.88	4677.57	4698.35	4695.28	4692.51
研磨後	4668.88	4627.79	4624.35	4676.81	4705.68	4618.27	4647.19	4639.14	4641.05
研磨厚度	33.833	54.503	50.703	15.383	-5.7976	59.303	51.163	56.143	51.4626
平均移除率			0.67212		不平	坦度		20.95533	
修正後之	移除率		2.70213						

表 5.28 模型 DF=2 psi, SP=30 rpm, FR=250m1/min

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4461.46	4441.19	4446.07	4460.91	4467.72	4474.61	4425.63	4460.6	4420.64
研磨後	4181.39	4192.56	4178.8	4179.13	4194.57	4179.07	4131.82	4181.89	4131.4
研磨厚度	280.074	248.634	267.269	281.784	273.154	295.539	293.814	278.714	289.244
平均移除率 4.6234			不平	坦度		13.80371			
修正後之	移除率		6.74569	antill .	Ulter,				

表 5.29 模型 DF=4 psi, SP=30 rpm, FR=250m1/min E S

第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
研磨前	4800.38	4768.94	4 778 .67	4802.09	4793.46	481 <mark>3.1</mark> 6	4814.12	4799.02	4809.55		
研磨後	4388.16	4353.06	4362.91	4408.55	4422.15	4423.06	4430	4374.47	4456		
研磨厚度	412.227	415.887	415.766	393.547	371.317	39 0.107	384.118	424.557	353.557		
平均移	除率		6.59385	"In	不平	坦度		22.2527			
修正後之	移除率		8.8084								

表 5.30 模型 DF=6 psi,SP=30 rpm,FR=250m1/min

研磨墊	Primary Pad
Time	60 sec
Down Force	2~6 psi
Back pressure	1/2 Down Force
Platen speed	20~40 rpm
Carrier Speed	20~40 rpm
Slurry	<i>Al₂O₃1%</i> +硝酸 0.616%+DI Water
Flow rate	150~250 ml/min

表 5.31 樣片實驗固定參數值

第01片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4878.06	4855.23	4887.23	4895.66	4982.52	4886.89	4948.86	4875.13	4874.25
研磨後	4867.45	4851.17	4885.75	4890.65	4974,32	4883.11	4940.05	4862.65	4865.31
研磨厚度	10.61	4.06	1.48	5.01	8.2	3.777	8.81	12.48	8.94
平均移除率 0.117346			不平	坦度		38.06793			
修正後之	移除率		0.1 <mark>17</mark> 346		2	1/2			

表 5.32 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=150m1/min

			E	X	896	3			
第02片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4971.53	4935.83	4917.11	4970.45	4974.22	4968.8	4984.85	4951.31	4921.08
研磨後	4953.93	4919.26	4913.77	4952.57	4962.78	4954.39	4970.13	4934.95	4903.78
研磨厚度	17.6	16.57	3.34	17.88	11.44	14.41	14.72	16.36	17.3
平均移	除率		0.240037		不平	坦度		22.20606	
修正後之	移除率		0.356529						

表 5.33 模型 DF=4 psi, SP=20 rpm, FR=150m1/min

第03片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4980.16	4947.06	4910.92	4981.83	4981.6	4978.55	4970.02	4965.17	4908.55
研磨後	4960.22	4933.14	4905.02	4964.59	4967.45	4965.91	4966.51	4943.67	4902.17
研磨厚度	19.94	9.13	3.71	13.28	8.23	12.94	10.75	26.49	15.19
平均移	除率	0.221593			不平	坦度		26.6753	
修正後之移除率 0.454576		j							

表 5.34 模型 DF=6 psi,SP=20 rpm,FR=150m1/min

第04片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4992.68	4953.08	4917.99	4980.21	4981.32	4983.93	4981.02	4965.5	4920.04
研磨後	4973.68	4952.54	4909.01	4964.03	4969.46	4972.66	4970.96	4942.45	4905.49
研磨厚度	19	0.54	8.98	16.18	11.86	11.27	10.06	23.05	14.55
平均移除率 0.21387			不平	坦度		25.39052	,		
修正後之移除率 0.563346		i							

表 5.35 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

第05片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4986.8	4953.04	4925.57	4987.61	4980.68	4985.73	4984.2	4968.86	4919.99
研磨後	4962.64	4936.57	4915.28	4964.58	4961.4	4956.92	4962.5	4938.3	4900.29
研磨厚度	24.16	16.47	10.29	23.03	19.28	28.81	21.7	30.56	19.7
平均移	除率		0.359259	ARTIN	不平	坦度		22.12424	
修正後之	移除率		0.825226		1	6			

表 5.36 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

					11 1				
第06片	1	2	-3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4989.58	4961.4	4924.64	4990.52	4984.24	4988.45	4985.68	4966.45	4920.11
研磨後	4956.67	4937.69	4901.34	4965	4965.69	49 54.93	4958.89	4927.45	4899.5
研磨厚度	32.91	23.71	23.3	25.52	18.55	33.52	26.79	39	20.61
平均移	除率		0.451685	i	不平	坦度		24.57322	2
修正後之	移除率		1.034144						

表 5.37 模型 DF=6 psi, SP=40 rpm, FR=150m1/min

第 07 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	4996.16	4961.02	4937.57	4992.11	4993.47	5000.93	4991.48	4976.99	4926.56
研磨後	4985.37	4959.48	4940.63	4987.39	4985.71	4993.18	4988.59	4969.4	4927.32
研磨厚度	10.79	1.54	-3.06	4.72	7.76	7.75	2.89	7.59	-0.76
平均移	·除率		0.07263		不平	坦度		22.25611	
修正後之	移除率		0.888072	2					

表 5.38 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

第08片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5002.49	4978.33	4944.24	4996.58	4987.16	5009.94	5000.86	4977.98	4930.88
研磨後	4980.32	4966.46	4936.46	4980.54	4978.58	4994.26	4991.82	4963.28	4922.58
研磨厚度	22.17	11.87	7.78	16.04	8.58	15.68	9.04	14.7	8.3
平均移	除率		0.211407		不平	坦度		22.99701	
修正後之	移除率		1.143342	,					

表 5.39 模型 DF=4 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

第09片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5016.99	4993.28	4963.45	5002.86	4998.17	5016.4	5012.32	4993.01	4937.36
研磨後	4996.26	4982.01	4958.47	4995.26	4992.93	5002.15	5002.56	4979.61	4926.06
研磨厚度	20.73	11.27	4.98	7.6	5.24	14.25	9.76	13.4	11.3
平均移	除率		0.182463		不平	坦度		23.60609	
修正後之	移除率		1.230889	antill	Lites,				

表 5.40 模型 DF=6 psi, SP=20 rpm, FR=200m1/min

			The second se	Contraction of the local division of the loc					
第10片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5024.89	4996.47	4 973 .03	5017	5010.1	5021.27	5019.68	4998.92	4946.77
研磨後	5009.97	4997.49	4977.03	5018.82	5000.18	5023.05	5014.37	4990.96	4934.77
研磨厚度	14.92	-1.02	4	-1.82	9.92	-1.78	5.31	7.96	12
平均移	除率		0.076833	34	不平	坦度		25.68693	
修正後之	移除率		1.241751						

表 5.41 模型 DF=2 psi, SP=30 rpm, FR=200m1/min

第11片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5030.05	5002.94	4982.56	5026.1	5006.52	5037.69	5021.86	5009.11	4959.79
研磨後	5007.51	4988.49	4972.14	5012.49	4992.17	5023.41	5013.34	4988.31	4945.97
研磨厚度	22.54	14.45	10.42	13.61	14.35	14.28	8.52	20.8	13.82
平均移	除率		0.245907		不平	坦度		22.64137	,
修正後之	移除率		1.527317	,					

表 5.42 模型 DF=4 psi,SP=30 rpm,FR=200m1/min

第12片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5041.68	5024.52	4996.65	5038.58	5024.54	5047.88	5033.69	5024.44	4975.28
研磨後	5014.03	5012.08	4980.66	5020.62	5013.03	5030.35	5012.87	5005.18	4959.11
研磨厚度	27.65	12.44	15.99	17.96	11.51	17.53	20.82	19.26	16.17
平均移	除率		0.295056	i	不平	坦度		20.66155	
修正後之	移除率		1.692957						

表 5.43 模型 DF=6 psi, SP=30 rpm, FR=200m1/min

第13片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5052.12	5036.45	5012.36	5041.97	5030.41	5054.57	5046.27	5032.47	4982.27
研磨後	5045.62	5038.98	5001.5	5041.49	5017.56	5046.63	5033.03	5026.44	4973.97
研磨厚度	6.5	-2.53	10.86	0.48	12.85	7.94	13.24	6.03	8.3
平均移	除率		0.117907		不平	坦度		22.70246	
修正後之	移除率		1.6323	ARTER.	aller,				

表 5.44 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=200m1/min

				the second second					
第14片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5064.32	5049.64	5025.51	5060.94	5050.41	5065.79	5066.74	5045.31	4998.22
研磨後	5034.66	5033.86	5010.23	5040.02	5038.34	5037.2	5043.18	5025.82	4974.15
研磨厚度	29.66	15.78	15.28	20.92	12.07	28.59	23.56	19.49	24.07
平均移	除率		0.350778	m	不平	坦度		20.66135	
修正後之	移除率		1.981663						

表 5.45 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=200m1/min

第15片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5085.1	5063.88	5043.79	5076.62	5058	5079.68	5075.69	5058.95	5000.42
研磨後	5069.4	5033.86	5010.23	5040.02	5038.34	5037.2	5043.18	5025.82	4974.15
研磨厚度	15.7	15.57	12.26	15.66	16.59	15.66	14.44	17.22	10.81
平均移	除率		0.247981		不平	坦度		22.99464	-
修正後之	移除率		1.995358	5					

表 5.46 模型 DF=6 psi, SP=40 rpm, FR=200m1/min

第16片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5101.33	5084.96	5068.35	5095.35	5075.02	5108.31	5093.05	5076.91	5016.39
研磨後	5094.38	5087.12	5071.09	5091.02	5072.03	5103.41	5086.66	5075.45	5016.91
研磨厚度	6.95	-2.16	-2.74	4.33	2.99	4.9	6.39	1.46	-0.52
平均移	除率		0.04		不平	坦度		23.7155	
修正後之	移除率		1.903868						

表 5.47 模型 DF=2 psi, SP=20 rpm, FR=250m1/min

第17片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5117.02	5100.05	5085.5	5105.77	5087.46	5120.7	5109.32	5096.56	5032.76
研磨後	5102.76	5089.98	5076.38	5093.76	5082.26	5109.99	5102.44	5078.54	5023.55
研磨厚度	14.26	10.07	9.12	12.01	5.2	10.71	6.88	18.02	9.21
平均移	除率		0.176815	í	不平	坦度		24.13409	1
修正後之	移除率	除率 2.157175			Mary,				

表 5.48 模型 DF=4 psi, SP=20 rpm, FR=250m1/min

				the second s	and the second second				
第18片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5147.11	5129.22	5116.59	5133.34	5113.53	514 <mark>7.8</mark> 3	5139.62	5120.33	5053.79
研磨後	5127.59	5122.71	5103.06	5166.37	5102.71	5134.86	5130.99	5105.14	5046.21
研磨厚度	19.52	6.51	13.53	-33.03	10.82	12.97	8.63	15.19	7.58
平均移	除率		0.114296	300	不平	坦度		30.96132	,
修正後之	移除率		2.211148						

表 5.49 模型 DF=6 psi, SP=20 rpm, FR=250m1/min

第19片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5160.29	5147.64	5140.43	5154.55	5135.31	5175.06	5160.27	5136.78	5070.11
研磨後	5154.82	5143.99	5133.58	5143.62	5120.25	5157.08	5146.44	5131.23	5059.65
研磨厚度	5.47	3.65	6.85	10.93	15.06	17.98	13.83	5.55	10.46
平均移	除率		0.166259)	不平	坦度		27.91245	i
修正後之	移除率	2.379603							

表 5.50 模型 DF=2 psi, SP=30 rpm, FR=250m1/min

第 20 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5187.72	5168.61	5160.35	5179.35	5158.53	5194.27	5186.72	5167.93	5106.68
研磨後	5160.13	5151.73	5145.73	5156.06	5141.19	5164.94	5168.48	5141.27	5090.81
研磨厚度	27.59	16.88	14.62	23.29	17.34	29.33	18.24	26.66	15.87
平均移	除率		0.351519		不平	坦度		21.81951	
修正後之	移除率		2.681354	-					

表 5.51 模型 DF=4 psi, SP=30 rpm, FR=250m1/min

第21片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5203.08	5194.18	5184.48	5192.96	5164.65	5211.94	5206.81	5177.32	5125.34
研磨後	5172.03	5175.55	5160.94	5168.16	5144.03	5185.46	5181.27	5148.67	5105.32
研磨厚度	31.05	18.63	23.54	24.8	20.62	26.48	25.54	28.65	20.02
平均移	除率		0.406167	,	不平	坦度		23.3992	
修正後之	移除率	除率 2.852494			aller,				

表 5.52 模型 DF=6 psi, SP=30 rpm, FR=250m1/min E S

				Contraction of the local division of the loc	100 March 100 Ma				
第 22 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5210.43	5199.47	5206 .01	5208.83	5188.42	5229.61	5228.1	5205.07	5165.91
研磨後	5209.92	5198.64	5194.82	5188.86	5161.18	5215.61	5213.38	5192.87	5145.1
研磨厚度	0.51	0.83	11.19	19.97	27.24	14	14.72	12.2	20.81
平均移	除率		0.224944	"ma	不平	坦度		22.46319)
修正後之	移除率		2.787763						

表 5.53 模型 DF=2 psi, SP=40 rpm, FR=250m1/min

第23片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5237.14	5226.95	5236.89	5233.56	5227.07	5243.46	5256.1	5232.45	5201.01
研磨後	5199.49	5200.06	5210.88	5198.97	5195.5	5203.44	5230.92	5193.02	5172.57
研磨厚度	37.65	26.89	26.01	34.59	31.57	40.02	25.18	39.43	28.44
平均移	除率		0.53663		不平	坦度		14.55389)
修正後之	修正後之移除率 3.21594								

表 5.54 模型 DF=4 psi, SP=40 rpm, FR=250m1/min

第 24 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5199.49	5200.06	5210.88	5198.97	5195.5	5203.44	5230.92	5193.02	5172.57
研磨後	5163.07	5159.8	5171.04	5166.39	5171.64	5173.74	5199.28	5154.81	5145.12
研磨厚度	36.42	40.26	39.84	32.58	23.86	29.7	31.64	38.21	27.45
平均移	除率		0.555481		不平	坦度		14.21997	,
修正後之	移除率		3.351284	-					

表 5.55 模型 DF=6 psi, SP=40 rpm, FR=250m1/min

第 25 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5209.92	5198.64	5194.82	5188.86	5161.18	5215.61	5213.38	5192.87	5145.1
研磨後	5206.93	5193.37	5171.77	5185.66	5148.81	5210.45	5197.45	5190.79	5136.92
研磨厚度	2.99	5.27	23.05	3.2	12.37	5.16	15.93	2.08	8.18
平均移	除率		0.14487		不平	坦度		23.86552	
修正後之	移除率		0.377854	ARTER.	aller,				

表 5.56 模型 DF=2 psi, SP=30 rpm, FR=150m1/min E S

			The second second second	the second s	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the second second			
第26片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5172.03	5175.55	5 <mark>160</mark> .94	5168.16	5144.03	5185.46	5181.27	5148.67	5105.32
研磨後	5146.41	5148.1	5143.82	5145.79	5124.62	5162.16	5156.63	5125.49	5086.44
研磨厚度	25.62	27.45	17.12	22.37	19.41	23.3	24.64	23.18	18.88
平均移	除率		0.374019	"m	不平	坦度		21.58013	
修正後之	移除率		0.607002	2					

表 5.57 模型 DF=4 psi, SP=30 rpm, FR=150m1/min

第 27 片	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研磨前	5160.13	5151.73	5145.73	5156.06	5141.19	5164.94	5168.48	5141.27	5090.81
研磨後	5133.85	5124.53	5135.01	5133.68	5120.56	5133.11	5137.85	5113.95	5077.43
研磨厚度	26.28	27.2	10.72	22.38	20.63	31.83	30.63	27.32	13.38
平均移	除率		0.389574	-	不平	坦度		17.84066	5
修正後之	移除率	0.739049)					

表 5.58 模型 DF=6 psi, SP=30 rpm, FR=150m1/min











圖 2.1 化學機械研磨機台外觀圖[8]







圖 2.3 熱場發射掃描式電子顯微鏡-TFSEM 結構圖[8]

	分析項目	檢測說明	範例
1	SEI (二次電子影像)	檢測樣品表面形貌觀測	
2	BEI (反射電子影像)	化學組成差異影像觀測	NL 2007 1004 44,00 - 30- W24.04





圖 2.5 熱場發射掃描式電子顯微鏡掃出之圖



圖 2.7 NK1500-薄膜厚度分析儀外觀[8]



圖 3.1 製程或系統模圖[13]



圖 4.1 n&k 薄膜測厚儀量測之9點之簡圖


圖 5.2 硝酸對 Cu 及 SiO_2 之移除率比較圖



圖 5.4 樣片之移除率下降模型圖







圖 5.6 SiO2之控片不平坦度



圖 5.7 樣片不平坦度

